

证券代码：605588

证券简称：冠石科技

南京冠石科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-002

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 战略发布会 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	天风证券：王昊哲
时间	2023年6月1日 10:00--11:00
地点	公司会议室电话交流
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：王顺利；技术负责人：陈新晋；财务总监：潘心月；证券事务代表：李蕾
投资者关系活动主要内容介绍	<p>2023年6月1日上午,投资者通过电话会议的方式,与公司进行沟通交流,主要内容如下:</p> <p>1. 目前半导体光掩膜版行业情况:</p> <p>在芯片供需缺口持续扩大、国家产业政策长期扶持以及产业资本积极投入的大背景下,国内晶圆制造厂加速扩产,根据 SEMI 预计,从 2021 年下半年到 2024 年,中国大陆地区将有 14 家 8 英寸晶圆厂及 15 家 12 英寸晶圆厂建成投产,下游产能快速扩张直接带动对半导体光掩膜版的需求量不断增加,市场呈现供不应求的态势。</p>

2. 本次募投项目的基本情况？

公司本次募集资金投资项目为“光掩膜版制造项目”，主要产品为半导体光掩膜版，系半导体产业链上游核心材料之一。基于产品用途的不同，光掩膜版主要应用于 IC、FPD、PCB、MEMS 等领域。主要针对 IC 端，是芯片制造中光刻工艺所使用的图形母版，可承载图形设计和工艺技术等知识产权信息，通过曝光将掩膜版上的电路图案转印到芯片上，从而实现芯片的批量化生产。

项目建成以后，将具备年产 12,450 片半导体光掩膜版的生产能力，产品制程覆盖 350-28nm（其中以 45-28nm 成熟制程为主），系市场主流中高端产品，可广泛应用于高性能计算、人工智能、移动通信、智能电网、高速轨道交通、新能源汽车、消费类电子等众多产业涉及的集成电路半导体领域，能够满足多类晶圆设计、晶圆代工企业的采购需求，以及先进半导体芯片封装、半导体器件等产品的应用需求。

3. 募投项目的建设及生产计划？

项目总建设期为 5 年，不同制程的光掩膜版达产时间主要取决于设备交期，首批设备交付后预计 2025 年公司即可实现 45nm 光掩膜版的量产，待全部设备交付后预计 2028 年可实现 28nm 光掩膜版的量产。

4. 公司的技术研发能力？

公司在半导体光掩膜版制造领域已组建专业的技术

	<p>团队，核心骨干人员曾就职于业内知名光掩膜厂，在光掩膜版领域具有扎实的技术研发能力以及丰富的生产制造经验。技术团队主要成员均在半导体行业龙头企业工作多年，在半导体光掩膜版领域拥有丰富的研发、生产、管理经验及行业资源，掌握了产品技术研发、生产制造、质量管控等方面的大量 Know-How，具备较强的自主研发能力，可以助力本次募投项目顺利落地。</p> <p>5. 公司的主营业务现状？</p> <p>公司主营业务为半导体显示器件、特种胶粘材料及其他，22 年营收 11.08 亿，净利润 0.82 亿。</p>
附件清单	无
日期	2023 年 6 月 1 日